



**VECTECH BGA1000**

## 紅外線 BGA 維修拆焊設備

BGA 紅外線拆焊設備採用微處理器控制和紅外線溫度感應器技術，能安全及精確的對於表面黏著零件進行解焊、迴焊元件。

BGA1000 型，採用紅外線溫度感應技術和微處理器控制。具有紅外線溫度感應器及非接觸式中等波長的紅外線加熱系統，可以精確解焊、迴焊 BGA 元件。解焊迴焊過程都經由非接觸式紅外線溫度感應器監視，並給予最佳的溫度曲線控制。BGA 零件解焊、迴焊的最佳溫度控制和非破壞性可以重複使用的 PC 板溫度，致使維修拆焊系統紅外線加熱功率為 1500W；無鉛錫球焊接須要更嚴苛的溫度要求，PC 板板溫得到更有效的控制，BGA1000 維修拆焊設備，採用閉環控制迴焊技術，PC 板加熱系統分佈均勻、峰值溫度對於無鉛錫球在迴焊時活化和溶錫溫度控制，達到最佳溫度值。

中等波長的紅外線加熱器，具有均勻和安全的加熱系統所必須的功率和實用性。對於 PC 板散熱條件太快或須要較高熱量拆焊 BGA（金屬、陶瓷）元件及無鉛錫球焊接，其解焊、迴焊時的高溫要求等，都可以輕易解焊、迴焊完成。紅外線加熱輻射線為可調式光圈系統，可以依 BGA 零件大小調整熱輻射窗口，有效保護拆焊 BGA 零件週邊 PC 板上對溫度敏感之元件。此套設備不須要安裝及更換不同尺寸 BGA 熱風嘴，即可完成 BGA 元件解焊及迴焊。

BGA1000 型，所採用「開放式目視工作環境」，換言之：在焊接過程中，即時可以校正加熱溫度。可另選購「BGA 錫球溶錫迴焊攝影監控系統」，此攝影監控系統在顯示器上視覺目視下，可以詳細觀察到 PC 板上 BGA 錫球溶化過程時，按下「相應校正鍵」按鍵鈕，記錄下錫球溶錫溶點溫度讀值。BGA 維修拆焊設備系統，設有 9 組工作溫度設定記憶參數，可以自行編制拆焊溫度值參數，亦可以進行溫度值參數修改。BGA 錫球溶錫迴焊攝影監控紅外線拆焊設備 Reflow Process Camera 的使用，此系統為完整呈現維修拆焊 BGA 元件，錫球活化溶錫溫度的精確判斷，提供關鍵性視覺訊息；及溫度輸出介面，RS232C 視窗版軟體，可與電腦連線。

BGA1000 型紅外線 BGA 維修拆焊設備提供 PC 板冷卻系統；及數字顯示 60W 高週波無鉛溫控烙鐵組，方便清除 BGA 零件及 PC 板上錫球錫渣。此一設備完整呈現，現代化高科技 BGA Rework 工作站。

## 紅外線加熱系統 (IR)

- 1· 輸出總功率： 1600W (Max)
- 2· 底部預熱功率： 800W (紅外線陶瓷預熱板)
- 3· 上部加熱功率： 780W (紅外線發熱管。波長約 2 ~ 18  $\mu$ m，尺寸：60 x60 mm)
- 4· 其他功率： 15W
- 5· 底部熱輻射預熱時間： 約 90s，紅外線陶瓷板面積尺寸：135 x250 mm
- 6· 上部加熱器可調整範圍： 20 ~ 60 mm
- 7· 上部加熱時間： 約 10s (室溫 ~ 230°C)
- 8· 真空泵： 12V/300mA，0.05
- 9· 底部冷卻風扇： 12V/90mA 12CFM
- 10· 上部冷卻風扇： 12V/300mA 15CFM
- 11· 紅外線對位燈管： 3V/30mA x2 只
- 12· LCD 讀值顯示窗： 65 x23.5 mm 16 x2 個字
- 13· 烙鐵筆： 數字顯示 60W 高週波溫控烙鐵
- 14· 溫度輸出介面： RS232C 視窗版軟體，可與電腦連線
- 15· 外接鍵盤： 8 個按鍵
- 16· 上下移動馬達： 24VDC/100mA
- 17· 上下移動臂行程： 93 mm
- 18· 紅外線測溫度感應器： 0°C ~ 300°C (測溫度範圍)
- 19· 外接 K-Type 感應器： (配件選購)
- 20· 外觀尺寸： 330 x280 x440 mm
- 21· 重量： 13 kg
- 22· 錫球溶錫監控系統： BGA 錫球溶錫迴焊攝影監控系統 (選配)。此攝影監控系統在顯示器上視覺目視下，可詳細觀察到 PC 板上 BGA 錫球溶化過程。

## VECTECH BGA1000 型

BGA 紅外線拆焊設備

產品外觀圖

